



DUAL-CURED CORE BUILD-UP MATERIAL

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT

DUAL-CURED CORE BUILD-UP MATERIAL

CLEARFIL™ DC CORE PLUS



ENGLISH

PRECAUTIONS

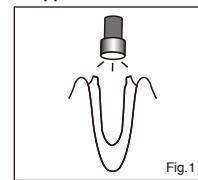
CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Precaution of the bonding system used in combination with CLEARFIL DC CORE PLUS]
Only CLEARFIL TRI-S BOND PLUS or dual-cured bonding agents can be used with CLEARFIL DC CORE PLUS. Do not use a light-cured bonding system except CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. In the areas where the light cannot reach easily (e.g. adherent areas masked by the post), "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" can be self-cured in contact with CLEARFIL DC CORE PLUS.

[Precaution of ambient light]
Be careful to prevent unnecessary exposure to direct sunlight or surgery operating lights, otherwise the paste inside the tip may harden, leading to a shortened working time.

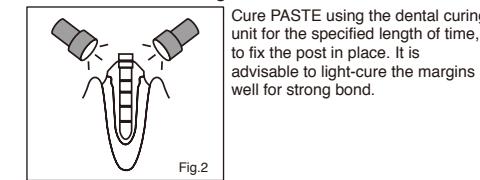
[Precaution of light curing]
Although CLEARFIL DC CORE PLUS is a dual-cured core build-up material, it must be light-cured in the following 3 procedures.

1. Application of BOND



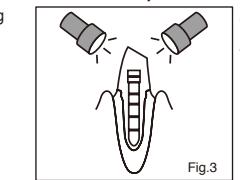
Light-cure BOND with a dental curing unit.

2. Post-cementation using CLEARFIL DC CORE PLUS



Cure PASTE using the dental curing unit for the specified length of time, to fix the post in place. It is advisable to light-cure the margins well for strong bond.

3. Core build-up



After placing PASTE around the post, light-cure the paste from both the lingual and the labial (buccal) sides, using a dental curing unit.

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

1. Use the light blocking plate to avoid exposing the material to an operating light or natural light, and use within 7 minutes after dispensing. As the volatile ethanol which is contained in the BOND evaporates, the viscosity increases, thereby making it difficult to apply.
2. During the application of the BOND to the adherent surface and the duration of leaving it in place for 10 seconds after the application, move the lighting-spot out of the mouth or turn off the light to prevent the applied BOND from being exposed to the operating light because the BOND may gelate when left under such a light. In addition, after treatment for 10 seconds, dry sufficiently as soon as possible by blowing mild air.

* CLEARFIL TRI-S BOND PLUS is a component of CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

FRANÇAIS

PRÉCAUTIONS

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Précautions relatives au système adhésif utilisé en combinaison avec CLEARFIL DC CORE PLUS]
Seuls CLEARFIL TRI-S BOND PLUS ou des agents adhésifs à double polymérisation peuvent être utilisés avec le produit. Ne pas utiliser un système adhésif photopolymérisable à l'exception de CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. Dans les zones où la lumière ne peut pas atteindre facilement la zone à traiter (p.ex. en cas de zones masquées par le tendon), "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" peut être autopolymérisé en contact avec le produit.

[Précautions relatives à la lumière ambiante]
Eviter toute exposition inutile à la lumière directe du soleil ou à des lampes opératoires chirurgicales, sinon la pâte contenue dans l'embout risque de durcir, raccourcissant ainsi le délai d'application.

[Précautions relatives à la photopolymérisation]
Bien que CLEARFIL DC CORE PLUS soit un matériau de reconstitution coronaire à double polymérisation, il doit être photopolymérisé dans les 3 procédures suivantes.

1. Application de BOND

Photopolymériser BOND au moyen d'une unité dentaire de polymérisation (Fig.1).

2. Cementation de tenons au moyen de CLEARFIL DC CORE PLUS

Polymeriser la PASTE au moyen de l'unité dentaire de polymérisation pendant la durée spécifiée afin de fixer le tenon en place. Il est recommandé de bien photopolymériser les bords pour une adhésion résistante (Fig.2).

3. Reconstitution coronaire

Après pose de la PASTE autour du tenon, la photopolymériser à la fois à partir des faces linguales et labiales en utilisant une unité dentaire de polymérisation (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

1. Utiliser la plaque protectrice contre la lumière pour éviter d'exposer le matériau à la lumière de la lampe d'opération ou à la lumière naturelle et utiliser dans les 7 minutes une fois versé. L'éthanol volatil contenu dans le BOND s'évapore ce qui accroît la viscosité du produit et rend son application difficile.
2. Pendant l'application du BOND sur la surface d'adhérence et les 10 secondes d'attente après application, détourner la lampe d'opération de la bouche du patient ou l'éteindre pour éviter que le BOND appliquée ne soit exposé à la lumière de la lampe d'opération et que le BOND ne se gélifie. Une fois les 10 secondes terminées, sécher correctement à l'aide d'un jet d'air frais le plus vite possible.

* CLEARFIL TRI-S BOND PLUS est un composant de CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

ESPAÑOL

PRECAUCIONES

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Precaución para el sistema adhesivo utilizado en combinación con CLEARFIL DC CORE PLUS]
Con el producto solo pueden utilizarse CLEARFIL TRI-S BOND PLUS o agentes adhesivos de doble curado. No utilice un sistema adhesivo fotopolimerizable excepto CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. En las áreas donde la luz no puede llegar fácilmente (por ejemplo áreas de adhesión enmascaradas por el poste), "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" puede autopolimerizarse en contacto con el producto.

[Precaución ante la luz ambiente]
Tenga precaución para impedir una exposición innecesaria a la luz directa del sol o a las luces de trabajo para cirugía, de lo contrario la pasta en el interior de la punta puede endurecerse, reduciéndose así el tiempo de trabajo.

[Precaución ante la fotopolimerización]
A pesar de que CLEARFIL DC CORE PLUS es un material de doble curado para la reconstrucción de muelones, debe fotopolimerizar de acuerdo con las instrucciones.

1. Aplicación del BOND

Fotopolimerizar el BOND con una lámpara de polimerización (Fig.1).

2. Cementación del poste utilizando CLEARFIL DC CORE PLUS

Polymerizar el PASTE utilizando la lámpara de polimerización durante el intervalo de tiempo especificado, para fijar el poste en su lugar. Es recomendable fotopolimerizar bien los márgenes para una unión fuerte (Fig.2).

3. Reconstrucción del muelón

Después de haber colocado el PASTE alrededor del poste, fotopolimerizar la pasta tanto por el lado lingual como por el labial (bucal), utilizando una lámpara de polimerización (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

1. Utilice la placa opaca para evitar la exposición del material a la luz de trabajo o natural y utilícela dentro de los 7 minutos tras la dosificación. Debido a que el etanol volátil contenido en el BOND se evapora, la viscosidad se incrementa, lo que dificulta su aplicación.
2. Durante la aplicación del BOND en la superficie adherente y mientras dura el tiempo de actuación de 10 segundos tras la aplicación, retirar el foco de luz de la boca o girar la luz para evitar que el BOND aplicado sea expuesto a la luz de trabajo ya que el BOND puede gelificarse bajo dicha luz. Además, tras el tratamiento de 10 segundos, secar suficientemente lo antes posible mediante la aplicación de un chorro de aire suave.

* CLEARFIL TRI-S BOND PLUS es un componente de CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

ITALIANO

PRECAUZIONI

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Precauzione per il sistema adesivo usato in combinazione con CLEARFIL DC CORE PLUS]
Con questo prodotto è possibile usare solo CLEARFIL TRI-S BOND PLUS o agenti leganti a polimerizzazione doppia. Non utilizzare sistemi leganti fotopolimerizzati diversi da CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. Nelle aree non raggiungibili facilmente dalla luce (ad esempio aree aderenze mascherate dal perno), "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" può essere fotopolimerizzato in contatto con il prodotto.

[Precauzione per la luce ambiente]

Attenzione: evitare un'esposizione non necessaria alla luce diretta del sole o a luci da sala operatoria, altrimenti la pasta all'interno della punta può indurirsi, portando ad una riduzione del tempo di lavoro.

[Precauzione per la fotopolimerizzazione]

Anche se CLEARFIL DC CORE PLUS è un materiale per moncone a polimerizzazione doppia, deve essere fotopolimerizzato in base alle seguenti 3 fasi.

1. Applicazione del BOND

Fotopolimerizzare il BOND con l'unità di polimerizzazione dentale (Fig.1).

2. Cementazione del perno con l'uso di CLEARFIL DC CORE PLUS

Polymerizzare PASTE usando l'unità di polimerizzazione dentale per l'intervallo di tempo specificato per fissare il perno nella sua sede. Si consiglia di fotopolimerizzare bene i margini per una forte adesione (Fig.2).

3. Costruzione del moncone

Dopo aver applicato PASTE intorno al perno, fotopolimerizzare la pasta dai due lati linguale e labiale (buccale) usando un'unità di polimerizzazione dentale (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

1. Usare la plasta di protezione contro la luce per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 7 minuti dalla sua erogazione. Quando l'etanolo volatil che è contenuto nel BOND evapora, la viscosità aumenta, rendendo il prodotto difficile da applicare.
2. Durante l'applicazione del BOND alla superficie aderente e durante il tempo di posa per i 10 secondi successivi all'applicazione, togliere la lampada dalla bocca e spegnere la luce per evitare l'esposizione alla luce operativa del BOND applicato, in quanto il BOND potrebbe gelatinizzare se lasciato sotto una luce di questo tipo. Inoltre, per i 10 secondi successivi al trattamento, asciugare a sufficienza quanto prima possibile, soffiando aria tiepida.

* CLEARFIL TRI-S BOND PLUS è un componente di CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

NEDERLANDS

VOORZORGSMAAATREGELEN

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Voorzorgsmaatregelen van het adhesiefsysteem in combinatie gebruikt met CLEARFIL DC CORE PLUS]
Dit product kan alleen met CLEARFIL TRI-S BOND PLUS of een dual-cure adhesief gebruikt worden. Gebruik geen ander lichtuithardend systeem dan CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. Op plaatsen waar het polymerisatielicht moeilijk bij kan (bijv. achter de stift) hardt "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" chemisch uit wanneer het in contact komt met het product.

[Voorzorg voor omgevingslicht]

Voorkom dat het onnodig blootstellen aan direct zonlicht of operatielicht; het mengsel binnen de tip kan daardoor uitharden, wat de werkzaamheidsduur verkort.

[Voorzorg voor lichtuitharding]

Hoewel CLEARFIL DC CORE PLUS een dual-cure (zowel chemisch- als lichtuithardend) opbouwmateriaal voor de stomp is, moet het met licht worden gepolymeriseerd bij de volgende procedures.

1. Aanbrengen van BOND (adhésif)

Hard de BOND uit met een polymerisatielamp (Fig.1).

2. Stiftcementatie met CLEARFIL DC CORE PLUS

Hard de PASTE met gebruik van de polymerisatielamp gedurende de aangegeven tijd, om de stift op zijn plaats te fixeren. Het is aan te bevelen de stomp goed te harden voor een sterke hechting (Fig.2).

3. Stompopbouw

Polymeriseer de PASTE na plaatsing rond de stift met een polymerisatielamp vanaf zowel de linguale als labiale (buccale) zijde (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

1. Gebruik de lichtschutplaat om te voorkomen dat het materiaal wordt blootgesteld aan het operatielicht of natuurlijk licht en gebruik binnen de 7 minuten na het uitdrukken. Aangezien de ethanol in de BOND verliest, vergroot de viscositeit, waardoor het product moeilijk te hanteren wordt.
2. Terwijl u de BOND aanbrengt op het hechtoppervlak en het product gedurende 10 seconden na het aanbrengen laat zitten, moet u de lichtspot van de mond wegdraaien of het licht uitschakelen om te voorkomen dat de aangebrachte BOND aan operatielicht wordt blootgesteld. De BOND kan namelijk een gelachige vorm aannemen wanneer hij in contact komt met dergelijk licht. Bovendien moet u de behandeling van 10 seconden zo snel mogelijk drogen door zachte lucht te blazen.

* CLEARFIL TRI-S BOND PLUS is een component van de CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

DEUTSCH

VORSICHTSMASSNAHMEN

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Vorsichtsmaßnahme hinsichtlich des in Verbindung mit CLEARFIL DC CORE PLUS verwendeten Bondingsystems]

Nur CLEARFIL TRI-S BOND PLUS oder dualhärtende Bondings können in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Mit Ausnahme von CLEARFIL TRI-S BOND PLUS kein rein lichthärtendes Bondingsystem verwenden. In den Bereichen, die mit Licht nur schwer zugänglich sind (z. B. Adhäsivbereiche, die vom Stift verdeckt sind), kann "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" in Kontakt mit dem Produkt selbst härteten.

[Vorsichtsmaßnahme hinsichtlich Umgebungslicht]

Darauf achten, dass das Produkt nicht unnötig direktem Sonnenlicht oder OP-Licht ausgesetzt wird, da ansonsten die Paste in der Kanüle aushärten könnte, was eine Verkürzung der Verarbeitungszeit zur Folge hätte.

[Vorsichtsmaßnahme hinsichtlich Lichthärtung]

Obwohl CLEARFIL DC CORE PLUS ein dualhärtendes Kernaufbaumaterial ist, muss es gemäß den 3 folgenden Verfahren lichthärtet werden.

1. Auftragen von BOND

BOND mit einem Polymerisationsgerät lichthärteten (Fig.1).

2. Festigung des Stifts mithilfe von CLEARFIL DC CORE PLUS

PASTE innerhalb der angegebenen Zeit mithilfe des Polymerisationsgeräts härteten, um den Stift zu fixieren. Es wird empfohlen, die Ränder für einen starken Haftverbund gut lichthärteten (Fig.2).

3. Stumpfaufbau

Nach dem Anbringen von PASTE um den Stift herum, diese mit einem Polymerisationsgerät von oral und vestibular lichthärteten (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

1. Die Lichtschutzplatte verwenden, damit das Material Behandlungslicht oder natürlichem Licht nicht ausgesetzt wird, und innerhalb von 7 Minuten ab dem Ausbringen verbrauchen. Sowie das im BOND enthaltene flüchtige Ethanol verdampft, steigt die Viskosität, was das Auftragen erschwert.
2. Darüber hinaus die Lichtquelle aus dem Mund nehmen oder das Licht ausschalten, wenn BOND auf die Haftoberfläche aufgetragen wird und während es 10 Sekunden nach dem Auftragen einwirkt, um das aufgetragene BOND nicht dem Behandlungslicht auszusetzen, da BOND ansonsten gelieren kann. Nach der 10 Sekunden dauernden Behandlung zusätzlich schnellstmöglich in ausreichendem Maße mit einem milden Luftstrom trocknen.

* CLEARFIL TRI-S BOND PLUS ist eine Komponente

NORSK

FORHOLDSREGLER

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Forholdsregler med henblikk på bondingsystemet som brukes sammen med CLEARFIL DC CORE PLUS]
Sammen med dette produktet kan det kun brukes CLEARFIL TRI-S BOND PLUS eller dualherdende bindingsmidler. Med unntak av CLEARFIL TRI-S BOND PLUS skal det ikke brukes lysherdende bondingsystemer. I områdene som er vanskelig tilgjengelige med lys (f.eks. hettende områder som tildekes av stiftene), kan CLEARFIL TRI-S BOND PLUS bli selvhærende ved kontakt med produktet.

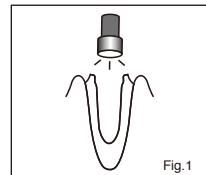
[Forholdsregler med henblikk på omgivelseslys]

Påse at produktet ikke unødig utsettes for sollys eller operasjonslys, ellers kan pastaen stivne i kanylen, hvilket vil føre til redusert bearbeidingstid.

[Forholdsregler med henblikk på lysherdning]

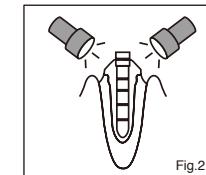
Selv om CLEARFIL DC CORE PLUS er et dobbelherdende materiale til konusoppbygg, skal det lysheres i henhold til de tre følgende prosessene.

1. Påføring av BOND



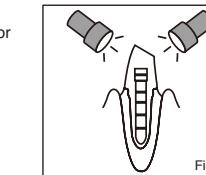
Herde BOND med en dentalherdeenhet.

2. Feste stiften ved hjelp av CLEARFIL DC CORE PLUS



Herde PASTE i løpet av angitt tid ved hjelp av dentalherdeenheten for å feste stiften. Det anbefales å lysherde kantene godt for å oppnå god heftekraft.

3. Konusoppbygg



Når PASTE har vært påført rundt stiften, skal den lysheres lingualt og labialt (bukkalt) med en dentalherdeenhet.

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

- Bruk den lysblokerende platen, slik at materialet ikke utsettes for behandlingslys eller naturlig lys. Bruk opp materialet innen 7 minutter etter at det er trykket ut. Så snart den flyktige etanolen i BOND fordamper, øker viskositeten, hvilket gjør påføringen vanskeligere.
- I tillegg skal lampen tas ut av munnen eller lyset slås av når BOND påføres på adhesjonsflaten og virker i 10 sekunder etter påføring. Dette er for å unngå at det påførte BOND utsettes for behandlingslyset, ettersom BOND ellers kan herde til en gel. Etter den 10 sekunder lange behandlingen skal det i tillegg så raskt som mulig torkes tilstrekkelig lenge med en mild luftstrom.

*CLEARFIL TRI-S BOND PLUS er en komponent i CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

SUOMI

TURVATOIMENPITEET

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[CLEARFIL DC CORE PLUS]-tuotteen kanssa käytettävä sidosjärjestelmän varotoimenpiteet]

Tuotteen kanssa voi käyttää vain CLEARFIL TRI-S BOND PLUS -ainetta tai kaksioskovettua sidosaineita. Älä käytä muita valokovetettaista kiinnitysjärjestelmää kuin CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. Alueilla, joihin valo ei pääse tuntkeutumaan helposti (esim. nastan peittämät tartunta-aluet), CLEARFIL TRI-S BOND PLUS -sidosainea kovettuu itseksseen, kun se joutuu kosketukseen tuotteen kanssa.

[Ympäristöön valoa koskeva varotoimenpide]

Vältä tarpeeton valoa koskevia varotoimenpiteitä. Vältä tarpeontona altistava suoralle aurinkovalolle tai toimenpidevalolle, sillä muuten kärjen sisällä oleva tahna saattaa kovettua ja työskentelyaika lyhentyä.

[Valokovetusta koskeva varotoimenpide]

Valoikäytävä CLEARFIL DC CORE PLUS on kaksioskovettua ytimen rakennusmateriaali, se on valokovetettava seuraavien 3 menettelyn mukaisesti.

1. BOND-sidosaineen levitys

Valokoveta BOND-sidosaine valokovetimella (Fig.1).

2. Pillari sementointi CLEARFIL DC CORE PLUS -tuotteella

Koveta PASTE valokovetimella ohjeen mukaista aikaa noudataan, jotta näta kiinnityt paikalleen. Reunat on suojaillutavaa valokovettaa huolellisesti, jotta sidoksesta tullee lujia (Fig.2).

3. Pillari rakentaminen

Kun PASTE on levitetty nastan ympärille, valokoveta tahna valokovetimella sekä kielen että huulen puolella (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

- Käytä valon pysäytävää suojalevyä, jotta aineeseen ei pääse lampun- tai luonnonvaloa, ja käytä aina 7 minuutin kuluessa annostelusta. BOND –sidosaineen sisältämän haittuvan etanolin haittuessa viskositeetti lisääntyy, mikä vaikuttaa tuotteen annosteluun.
- Sinä aikana kun BOND –sidosaineita annostellaan tarttupinnalle ja kun se jätetään 10 sekunniksi annostelun jälkeen vaikuttamaan, kohdevalo on poistettava suusta tai valo on summutettava, ettei annosteltu BOND –sidosaine altistu operatiivivalolle. BOND –sidosaine voi jähmettyä geelimäiseksi, mikäli se altistuu keinotekoiselle valolle. Lisäksi pinta on kuivattava mahdollisimman pian 10 sekunnin valkuutusajan jälkeen puhallamalla siihen ilmaa kevyesti.

*CLEARFIL TRI-S BOND PLUS kuuluu CLEARFIL DC CORE PLUS Kit -sarjaan.

DANSK

FORHOLDSREGLER

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Forholdsregler vedrørende bonding-systemet, anvendt i kombination med CLEARFIL DC CORE PLUS]

Kun CLEARFIL TRI-S BOND PLUS eller dualhærende bonding-materiale kan anvendes sammen med dette produkt. Anvend ikke andre lyshærende bonding-systemer end CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. I områder, der ikke er lette at belyse (fx adhærerende områder, der dækkes af stiftene), kan CLEARFIL TRI-S BOND PLUS selvhærdes ved kontakt med produktet.

[Forholdsregler vedrørende omgivende lys]

Undgå en unødvendig eksponering på grund af direkte sollys eller lys fra operationslamper. I modsat fald kan pastaen, der sidder i spidsen afbinde, hvilket medfører forkortet arbejdstid.

[Forholdsregler vedrørende lyshærdning]

Selvom CLEARFIL DC CORE PLUS er et dualhærende plastopbygningsmateriale, skal det lyshærdes i forbindelse med følgende 3 procedurer.

1. Aplicering af BOND

Lyshærdning af BOND med en hærdelampe (Fig.1).

2. Stift-cementering med CLEARFIL DC CORE PLUS

Lyshærdning af PASTE med en hærdelampe i det specificerede tidsrum for at fastgøre stiften på stedet. Det tilrådes at lyshærdne kantene godt, så en stærk binding sikres (Fig.2).

3. Kerneopbygning

Efter applicering af PASTE rundt om stiften, lyshærdnes pastaen både lingualt og labialt (bukkalt) med en hærdelampe (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

- Anvend en lysblokerende plade for at undgå at materialet udsættes for operationslys eller naturligt lys og anvend det inden for 7 minutter efter dispenseringen. Hvis det flyktige ethanol, som findes i BOND, fordamper, øges viskositeten, hvilket vanskeliggør produkets applicering.
- Under appliceringen af BOND til den adhærerende overflade samt medens det sidder på det pågældende sted i 10 sekunder efter appliceringen, skal lysplatten fjernes fra munnen eller lyset helt slukkes, så det applicerede BOND undgår at blive påvirket af operationslyset, idet BOND kan stivne, hvis det påvirkes af dette lys. Efter de 10 sekunders behandling skal der desuden hurtigt muligt torres omhyggeligt ved hjælp af en mild luftstrøm.

*CLEARFIL TRI-S BOND PLUS er en komponent af CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

PORTUGUÊS

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Precauções do sistema de adesão utilizado em associação com CLEARFIL DC CORE PLUS]
Só podem ser utilizados com o produto o CLEARFIL TRI-S BOND PLUS ou agentes de adesão de dupla polimerização. Não utilizar um sistema de adesão fotopolimerizado, excepto CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. Nas áreas onde a incidência da luz for difícil (p. ex., zonas aderentes dissimuladas pelo pino), o "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" pode ser auto-polimerizado em contacto com o produto.

[Precaução de luz ambiente]

Tomar as precauções necessárias para evitar uma exposição desnecessária à luz solar directa ou a fontes de luz utilizadas para cirurgia, caso contrário a pasta no interior da câmara poderá endurecer, implicando um encurtamento do tempo de processamento.

[Precaução de fotopolimerização]

Embora o CLEARFIL DC CORE PLUS seja um material de dupla polimerização para construção de núcleos, é necessário fotopolimerizar o mesmo com os 3 procedimentos seguintes.

1. Aplicação de BOND

Fotopolimerizar o BOND com uma unidade de polimerização dentária (Fig.1).

2. Cimentação do pino com CLEARFIL DC CORE PLUS

Polimerizar a PASTE utilizando a unidade de polimerização dentária durante o período de tempo especificado, para fixar o pino em posição. É aconselhável fotopolimerizar bem as margens para obter uma adesão forte (Fig.2).

3. Construção do núcleo

Após colocar a PASTE em redor do pino, fotopolimerizar a pasta do lado lingual e do lado labial (bucal), utilizando uma unidade de polimerização dentária (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

- Utilizar a placa de bloqueio de luminosidade para evitar a exposição do material a uma luz de trabalho ou à luz natural, e utilizar no prazo de 7 minutos após o doseamento. À medida que o etanol volátil contido no BOND se vai evaporando, a viscosidade aumenta, dificultando assim a aplicação do mesmo.
- Durante a aplicação do BOND na superfície aderente e durante o período de actuação de 10 segundos que se segue após a aplicação, deslocar o foco e luz para fora da boca ou desligar a luz, a fim de evitar que o BOND aplicado fique exposto à luz de trabalho, pois caso contrário o BOND poderá adquirir a consistência de gel. Além disso, após o tratamento durante 10 segundos, secar suficientemente assim que possível, utilizando sopro de ar moderado.

*CLEARFIL TRI-S BOND PLUS é uma componente do CLEARFIL DC CORE PLUS Kit.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (PASTE)

[Προφύλαξη από το συγκολλητικό σύστημα που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το CLEARFIL DC CORE PLUS]

Μόνο το CLEARFIL TRI-S BOND PLUS ή συγκολλητικοί παράγοντες διπλού πολυμερισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε άλλο φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό σύστημα εκτός από το CLEARFIL TRI-S BOND PLUS. Σε περιοχές όπου δύναται να φτάσει εύκολα το φως (π.χ. περιοχές προσκόλλησης που καλύπτονται από τον άξονα), το «CLEARFIL TRI-S BOND PLUS» μπορεί να αυτοπολυμεριστεί όταν έρθει σε επαφή με το προϊόν.

[Προφύλαξη από το φως του περιβάλλοντος]

Προσέρχεστε να μην εκβέβαιτε το υλικό στο άμεσο ηλιακό φως ή στο τεχνητό φως του ιατρείου χωρίς να υπάρχει λόγος, διαφορετικά η πάστα που βρίσκεται στο εσωτερικό του ρύγχους μπορεί να απλώνεται και έτσι να μειώσει ο χρόνος επεξεργασίας.

[Προφύλαξη από το φωτοπολυμερισμό]

Παρόλο που το CLEARFIL DC CORE PLUS είναι ένα υλικό ανασύστασης κολοβωμάτων διπλού πολυμερισμού, πρέπει να φωτοπολυμεριστεί με τις 3 ακόλουθες διαδικασίες.

1. Εφαρμογή του BOND

Φωτοπολυμερίστε το BOND με μία οδοντιατρική συσκευή πολυμερισμού (Fig.1).

2. Συγκόλληση άξονα χρησιμοποιώντας το CLEARFIL DC CORE PLUS

Πολυμερίστε το PASTE με την χρήση μιας οδοντιατρικής συσκευής πολυμερισμού για την συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, για να στερεώσετε τον άξονα στην θέση του. Συνιστάται να φωτοπολυμερίσετε τη οριακή σύσταση για να επιτύχετε ισχυρό δεσμό (Fig.2).

3. Ανασύσταση κολοβώματος

Μόλις τοποθετήστε το PASTE γύρω από τον άξονα, φωτοπολυμερίστε την πάστα και από την γλωσσική και από την χειλική (παρευάτη) πλευρά, χρησιμοποιώντας μια οδοντιατρική συσκευή πολυμερισμού (Fig.3).

CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS * (BOND)

- Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα για το φως για να εμποδίσετε την έκθεση του υλικού στο φως των λαμπτήρων ή στο φυσικό φως, και επεξεργαστείτε το εντός 7 λεπτών μετά την διανομή. Ενόσω η πηπούλη μιανόλη που περιέχεται στο BOND εξατμίζεται, το ιεώδες αυξάνεται, γι' αυτό είναι δύσκολη η επιστρώση του.
- Κατά τη διάρκεια της επιστρώσης του BOND στην συγκολλητική επιφάνεια και κατά την διάρκεια των 10 δευτερολέπτων της επί τόπου δράσης μετά την έκθεση του επιστρώμαντος BOND στο φως της εγχειρητικής λυχνίας, επειδή το BOND μπορεί να μετατραπεί σε πήκτωμα όταν αφεθεί κ